

# 2013年度第2四半期 決算説明会

2013年11月15日(金)

株式会社リョーサン

## 2013年度第2四半期 業績結果及び通期予想

## 2013年度 経営の取り組みの状況

### 資料取扱い上のご注意

このプレゼンテーションで述べられている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。その要因のうち、主なものは以下のとおりです。

- ・主要市場(日本、アジア等)の経済状況、消費動向及び製品需給の急激な変動
- ・ドル等の対円為替相場の大幅な変動
- ・資本市場における相場の大幅な変動等

## 2013年度第2四半期 業績結果及び通期予想

### 2013年度 経営の取り組みの状況

# 連結業績の概要

## 2012年度

	上期	下期	通期	
	実績	実績	実績	売上高比
売上高	1,061	1,003	2,065	
売上総利益	86	80	166	8.1%
販管費	64	64	129	6.3%
営業利益	21	15	36	1.8%
経常利益	25	15	41	2.0%
当期純利益	15	12	28	1.4%
1株当たり当期純利益	46円40銭	38円00銭	84円40銭	

## 2013年度

上期		下期		通期		
実績	前年同期比	計画	前年同期比	計画	売上高比	前年比
1,110	+4.6%	1,139	+13.5%	2,250		+8.9%
91	+5.6%	94	+16.8%	185	8.2%	+11.0%
68	+6.1%	66	+1.7%	135	6.0%	+3.9%
22	+4.2%	27	+79.7%	50	2.2%	+36.1%
21	△15.2%	28	+81.1%	50	2.2%	+21.6%
13	△13.7%	17	+39.5%	31	1.4%	+10.1%
42円16銭		55円84銭		98円00銭		

	実績	実績	実績	構成比
国内売上高	687	624	1,312	64%
海外売上高	374	378	752	36%

実績	前年同期比	計画	前年同期比	計画	構成比	前年比
594	△13.5%	605	△3.2%	1,200	53%	△8.6%
516	+37.9%	533	+41.0%	1,050	47%	+39.5%

# 事業別業績の概要

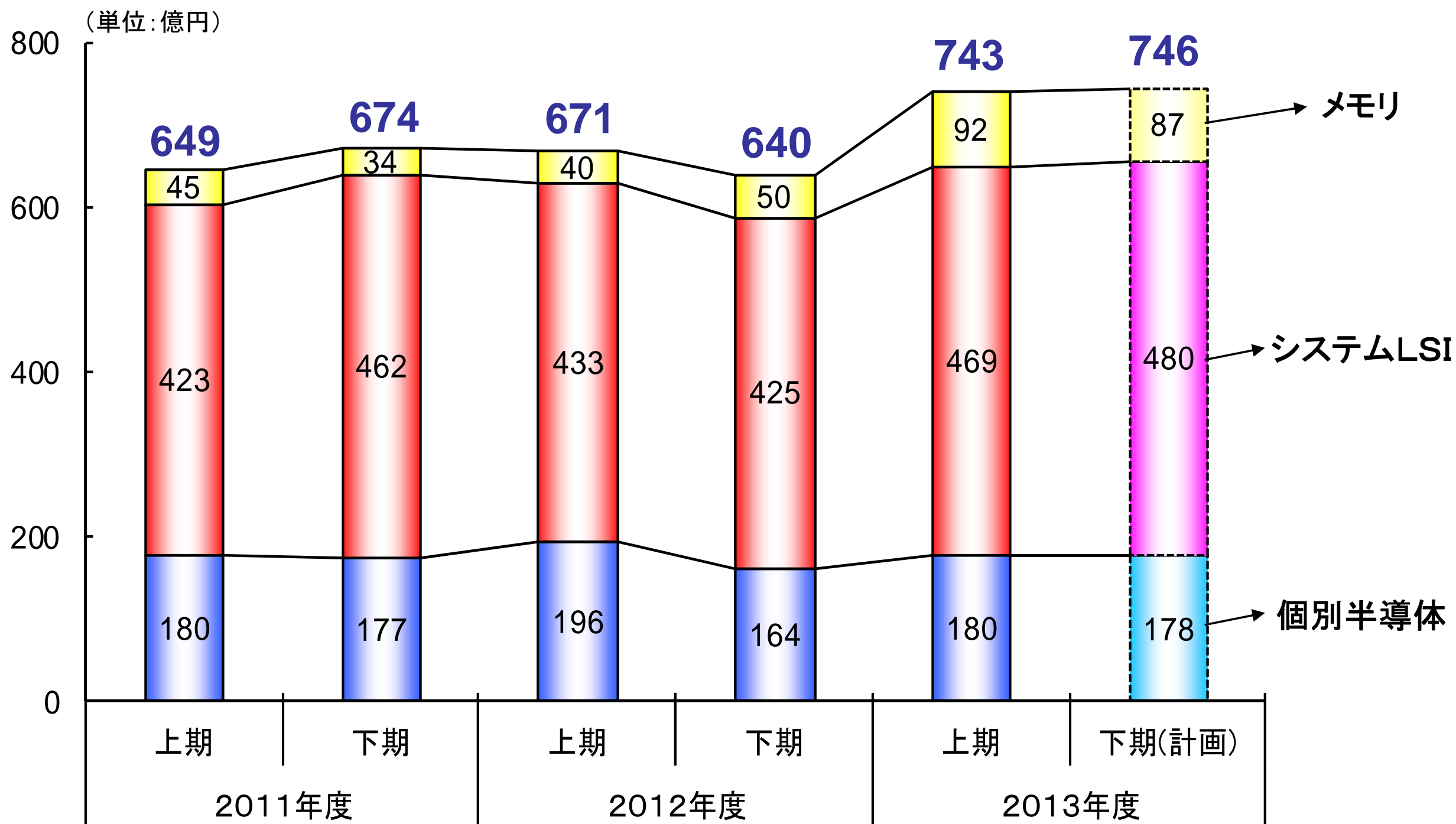
2012年度

2013年度

		2012年度			2013年度					
		上期	下期	通期	上期		下期		通期	
		実績	実績	実績	実績	前年同期比	計画	前年同期比	計画	前年比
半 導 体 事 業	売 上 高	67,106	64,066	131,172	74,332	+10.8%	74,668	+16.5%	149,000	+13.6%
	営 業 利 益	1,169	765	1,934	1,364	+16.7%	1,636	+113.9%	3,000	+55.1%
電 子 部 品 事 業	売 上 高	26,884	24,124	51,008	25,895	△3.7%	27,105	+12.4%	53,000	+3.9%
	営 業 利 益	660	544	1,204	654	△0.9%	796	+46.3%	1,450	+20.4%
電 子 機 器 事 業	売 上 高	9,620	9,899	19,519	8,285	△13.9%	9,715	△1.9%	18,000	△7.8%
	営 業 利 益	334	519	853	307	△8.1%	343	△33.9%	650	△23.8%
生 産 事 業	売 上 高	2,573	2,260	4,833	2,579	+0.2%	2,421	+7.1%	5,000	+3.5%
	営 業 利 益	39	△27	12	△2	-	52	-	50	+316.7%
調 整 額		△83	△248	△331	△115	-	△35	-	△150	-
連 結 計	売 上 高	106,185	100,349	206,534	111,092	+4.6%	113,908	+13.5%	225,000	+8.9%
	営 業 利 益	2,119	1,554	3,673	2,208	+4.2%	2,792	+79.7%	5,000	+36.1%

# 半導体事業の売上高推移(商品別)

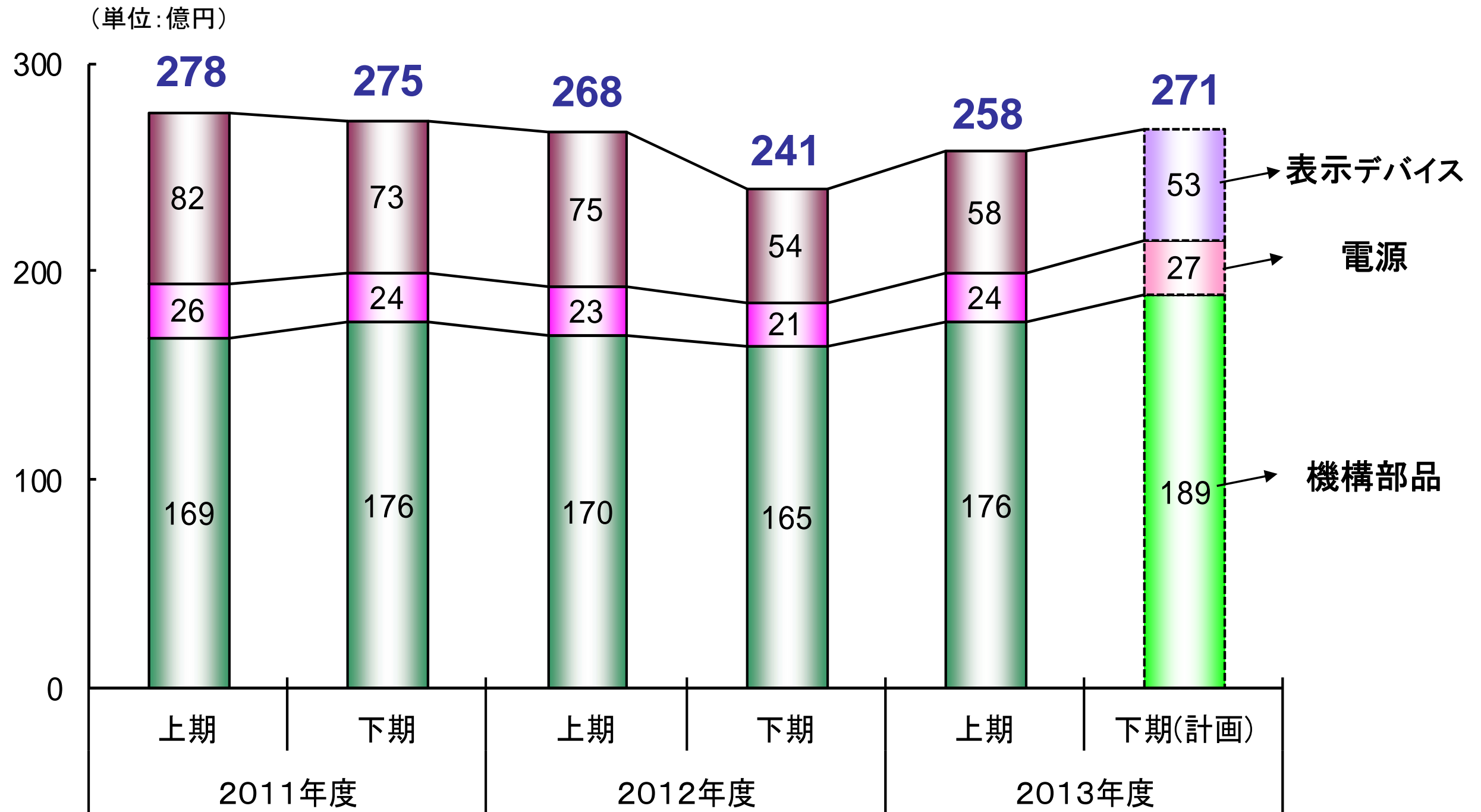
13年度上期概況: 車載電装向けシステムLSI、スマートフォン向けメモリ等が好調に推移。  
 13年度下期計画: 引き続き車載電装向けシステムLSI、スマートフォン向けメモリ等が好調に推移する計画。



# 電子部品事業の売上高推移(商品別)

13年度上期概況: 車載電装向け機構部品等の売上が増加したものの、デジタルカメラ向け表示デバイス等が伸び悩む。

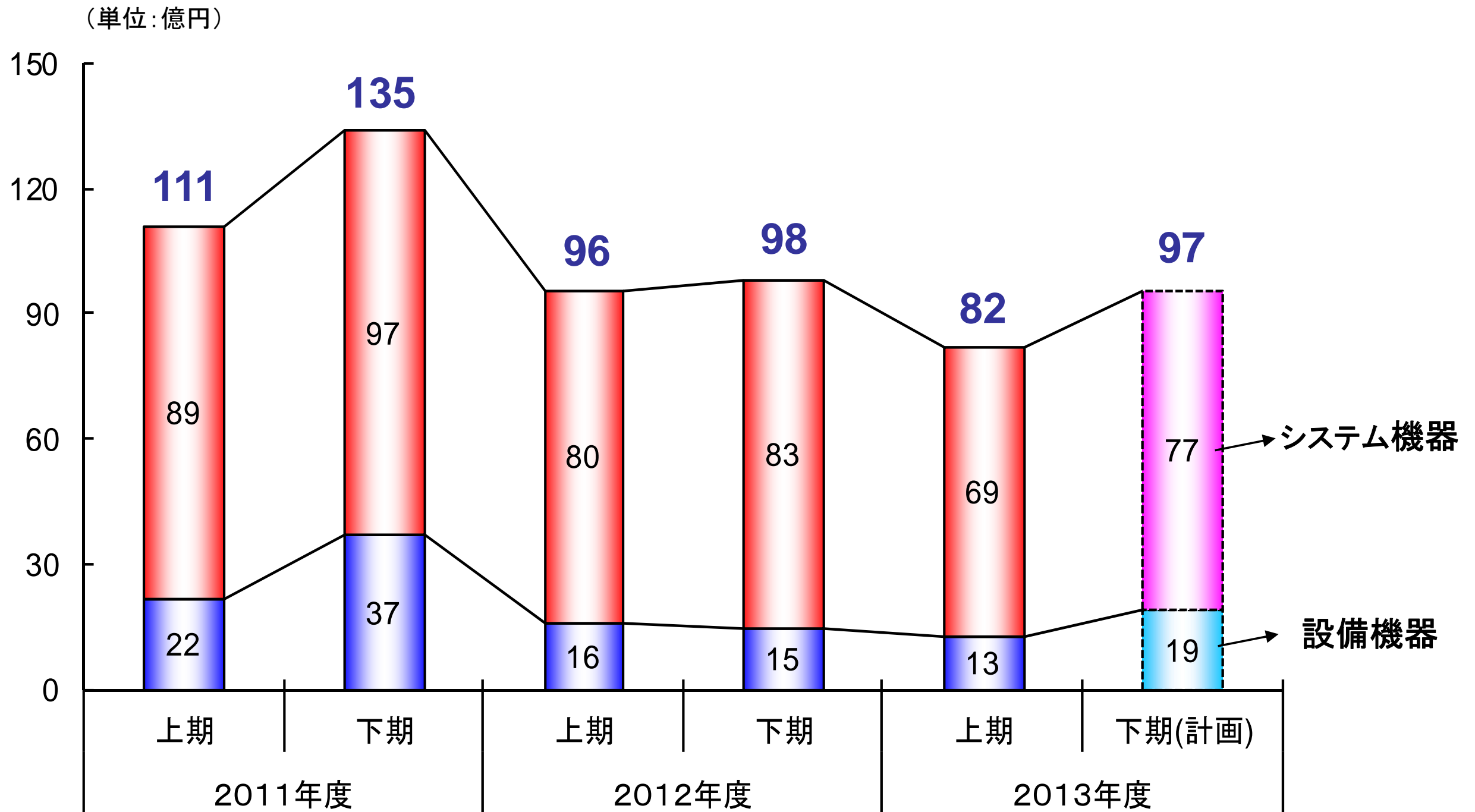
13年度下期計画: 車載電装向け、スマートフォン向け機構部品等の売上が増加する計画。



# 電子機器事業の売上高推移(商品別)

13年度上期概況: 車載電装向けシステム機器等の売上が減少。

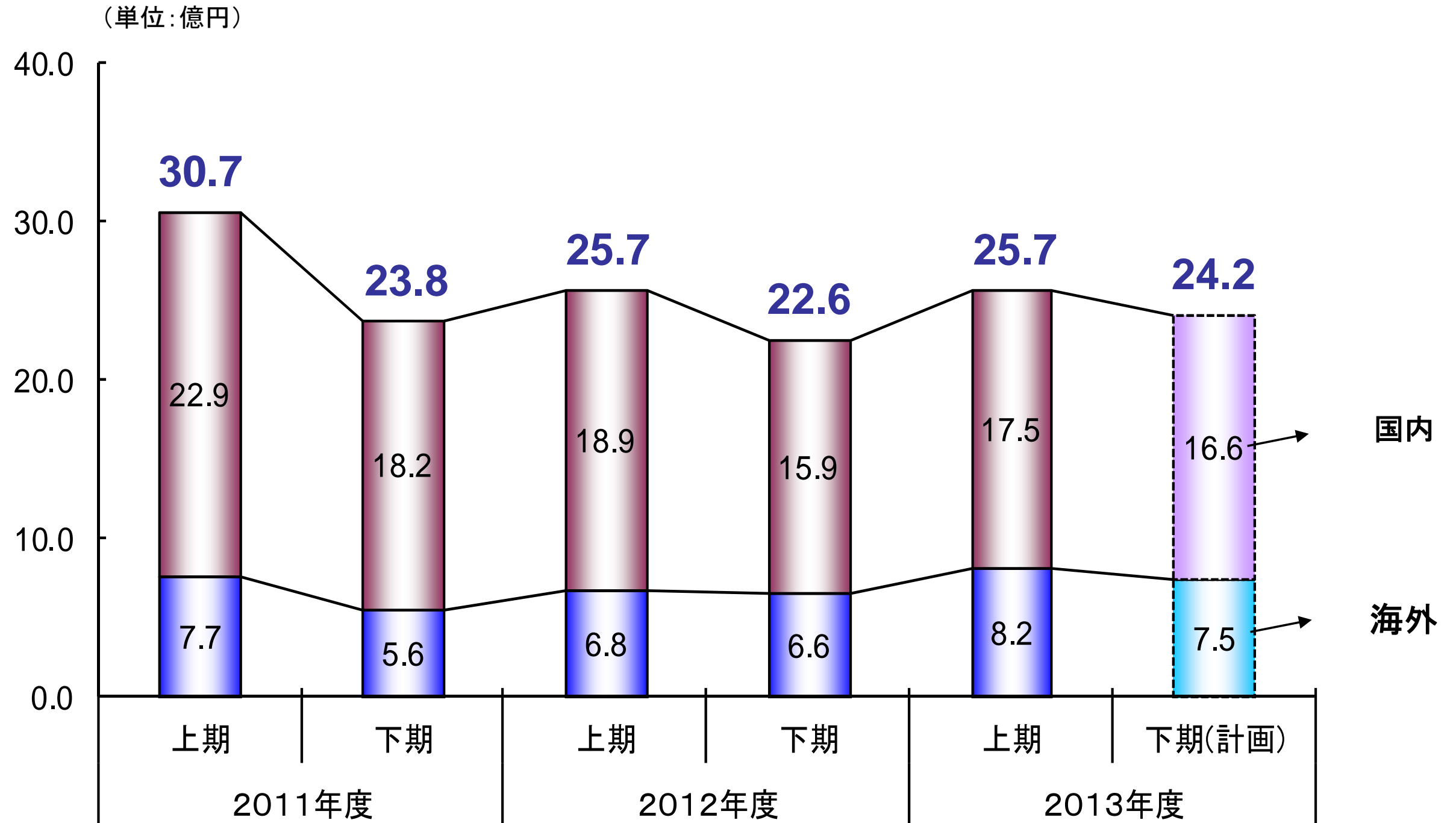
13年度下期計画: 複合機向けシステム機器、スパッタリング装置等の売上が増加する計画。



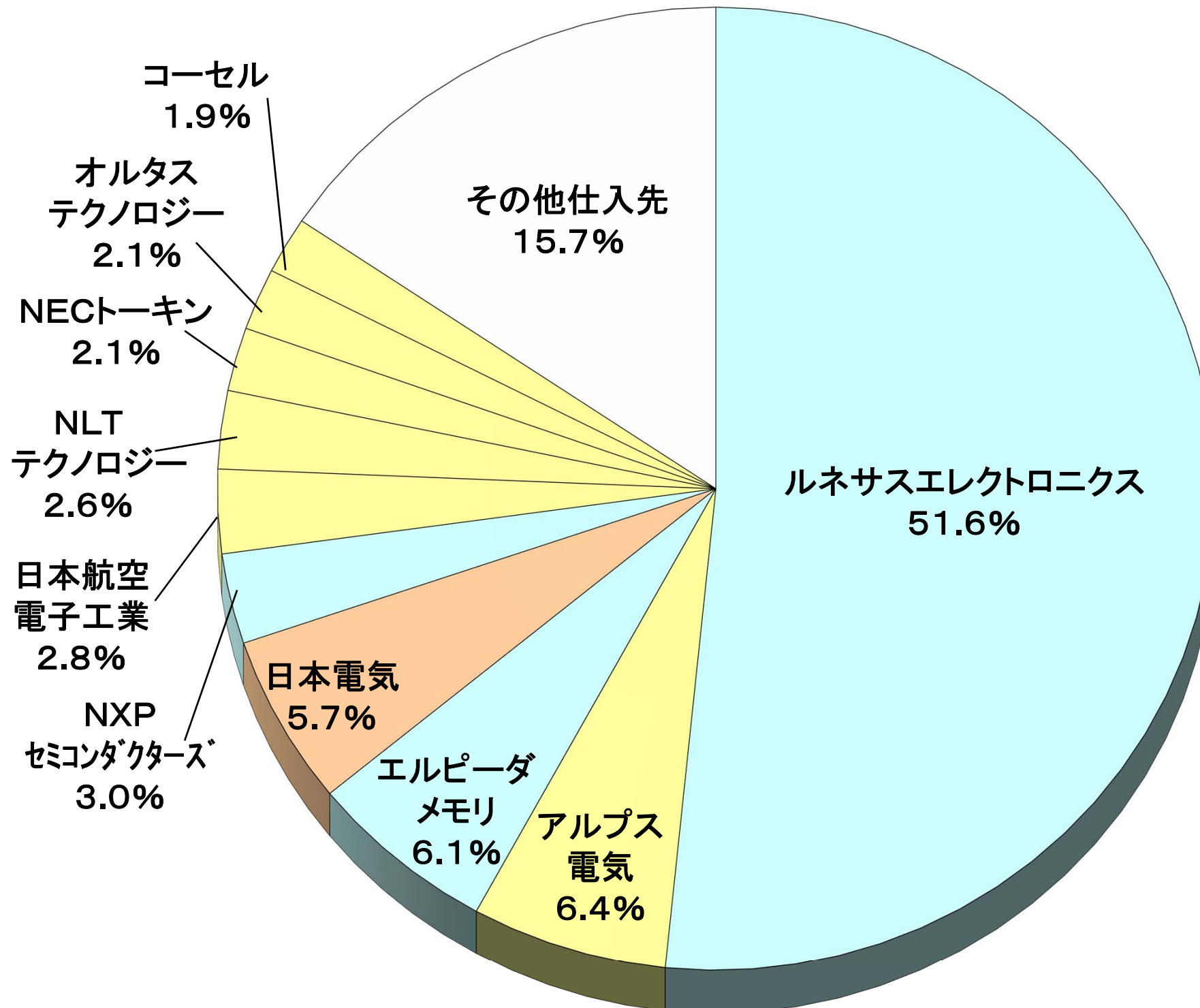


# 生産事業の売上高推移(地域別)

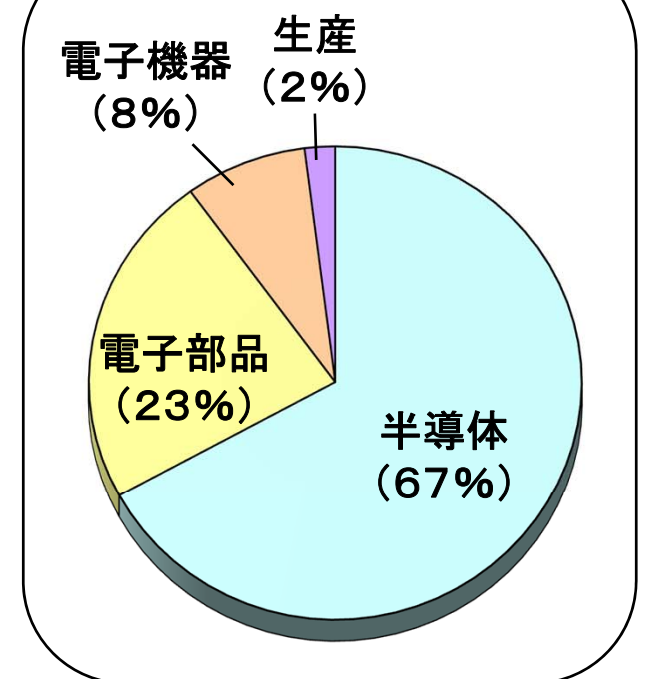
13年度上期概況: 白物家電向け等のヒートシンクの売上が増加。  
13年度下期計画: 国内、海外共に上期と同等に推移する計画。



# 主要仕入先様



【事業別売上構成比】



※1. 敬称略

※2. 構成比(%)は各仕入先商品の2013年度上期売上実績に基づく

# 主要得意先様

## 《売上高上位40社》

	上位1～10社	上位11～20社	上位21～30社	上位31～40社
顧客名 (アルファベット順)	アルパイン カシオ計算機 日立製作所 三菱電機 日本電気 ニコン オムロン パイオニア SAMSUNG(韓) ワコム	アルプス電気 ブラザー工業 カルソニックカンセイ デンソー 富士フイルム 現代自動車(韓) JABIL(米) 任天堂 パナソニック 住友電装	キヤノン 富士ゼロックス マミヤ・オーピー スタンレー電気 住友電気工業 TOPRO(中) 東芝テック Wuhan Fiberhome(中) ヤマハ 矢崎総業	アドバンテスト BLUEWAY(中) クラリオン 富士通 古野電気 JVCケンウッド コニカミノルタ シャープ TCL(中) ヨコオ
売上高 構成比	(上位10社) 51%	(上位20社) 68%	(上位30社) 75%	(上位40社) 80%

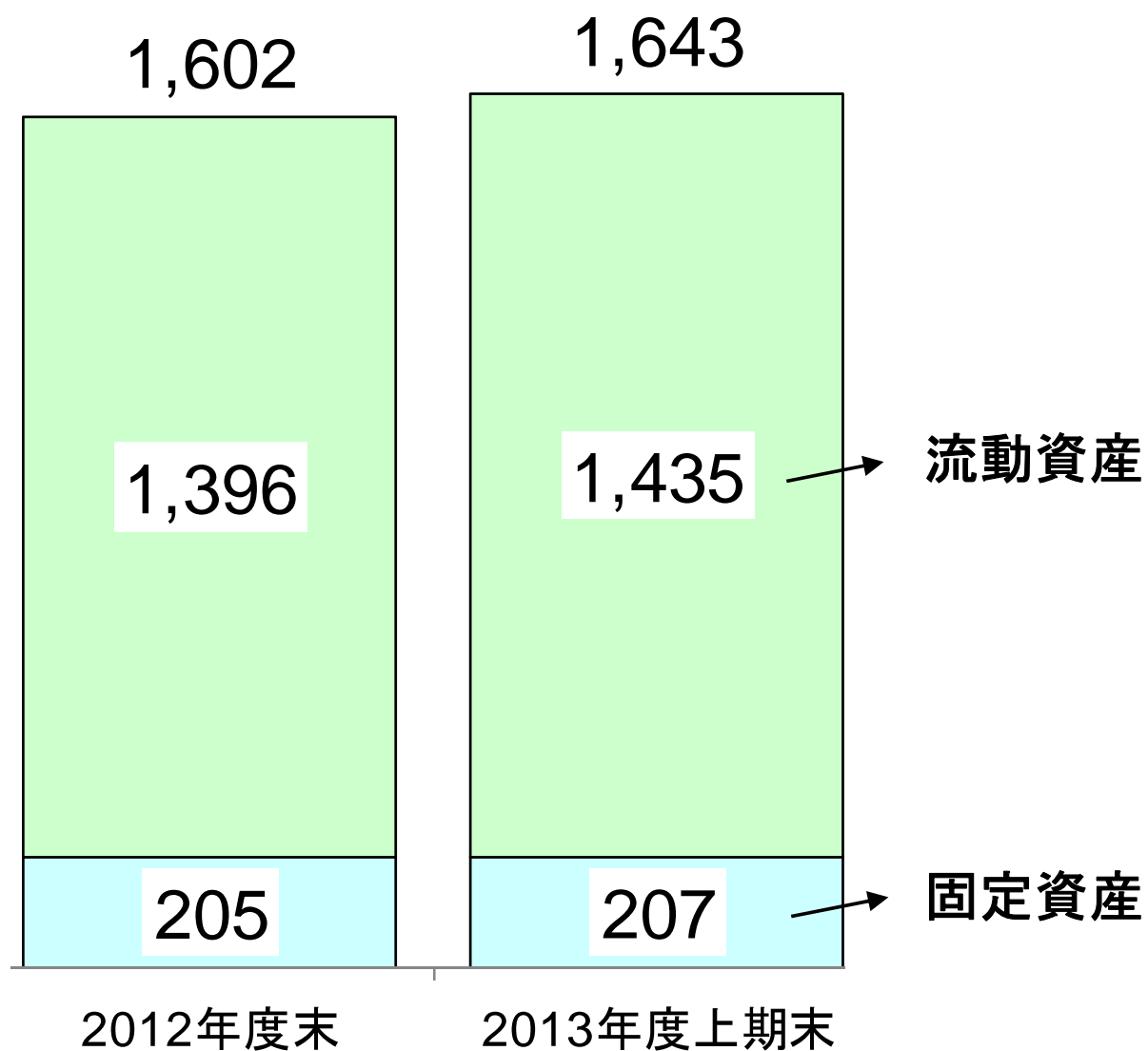
※1. 敬称略

※2. 順位、構成比(%)は2013年度上期売上実績に基づく

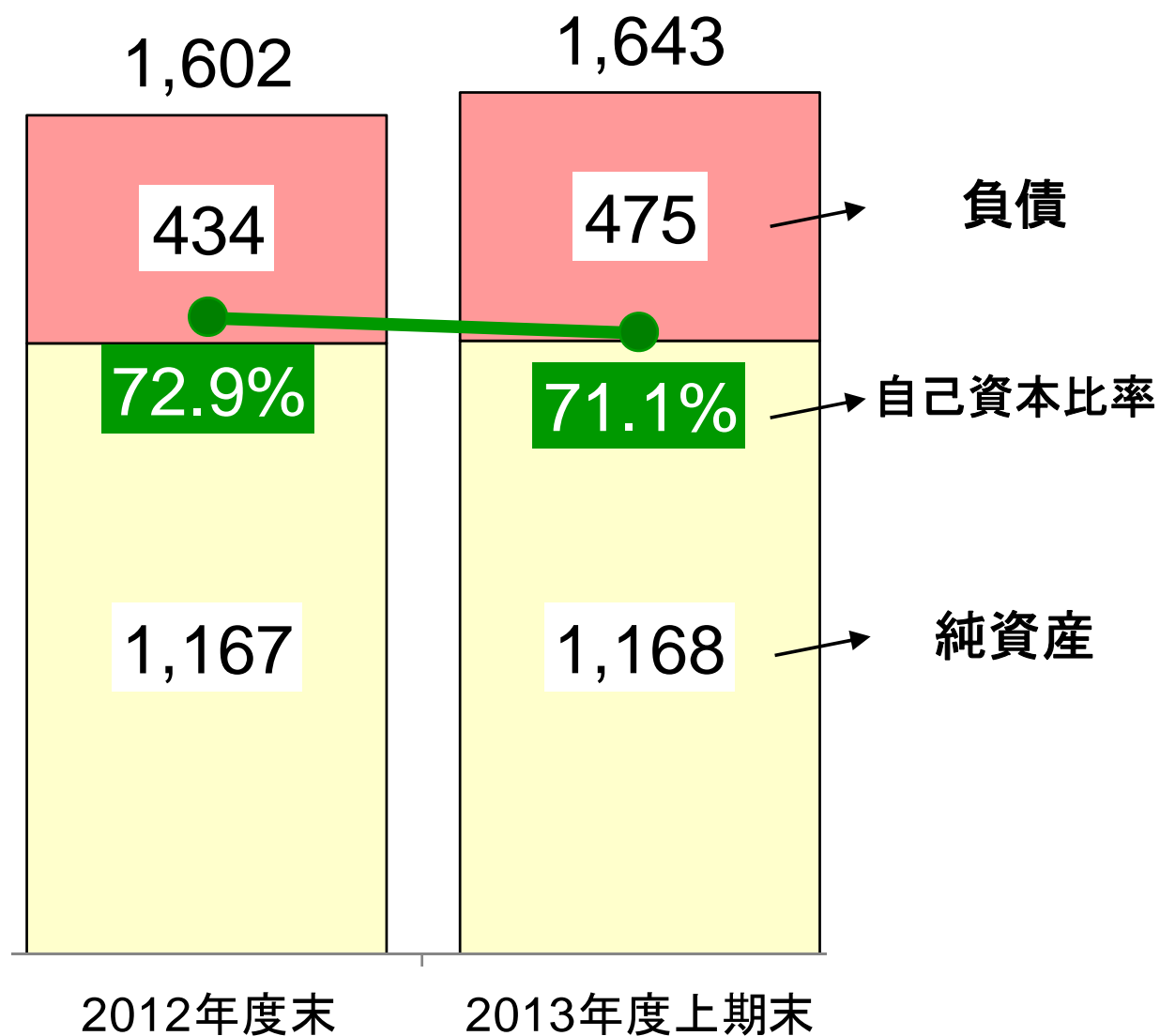
※3. (韓)は韓国、(米)は米国、(中)は中国の顧客

# 連結貸借対照表

## ◆ 資産



## ◆ 負債・純資産



### 主要な増減

	2013年度 上期末	増減		2013年度 上期末	増減
現金及び預金・有価証券	494	△10	買掛金	290	+38
受取手形及び売掛金	703	+22	短期借入金	136	+7
たな卸資産	223	+32			

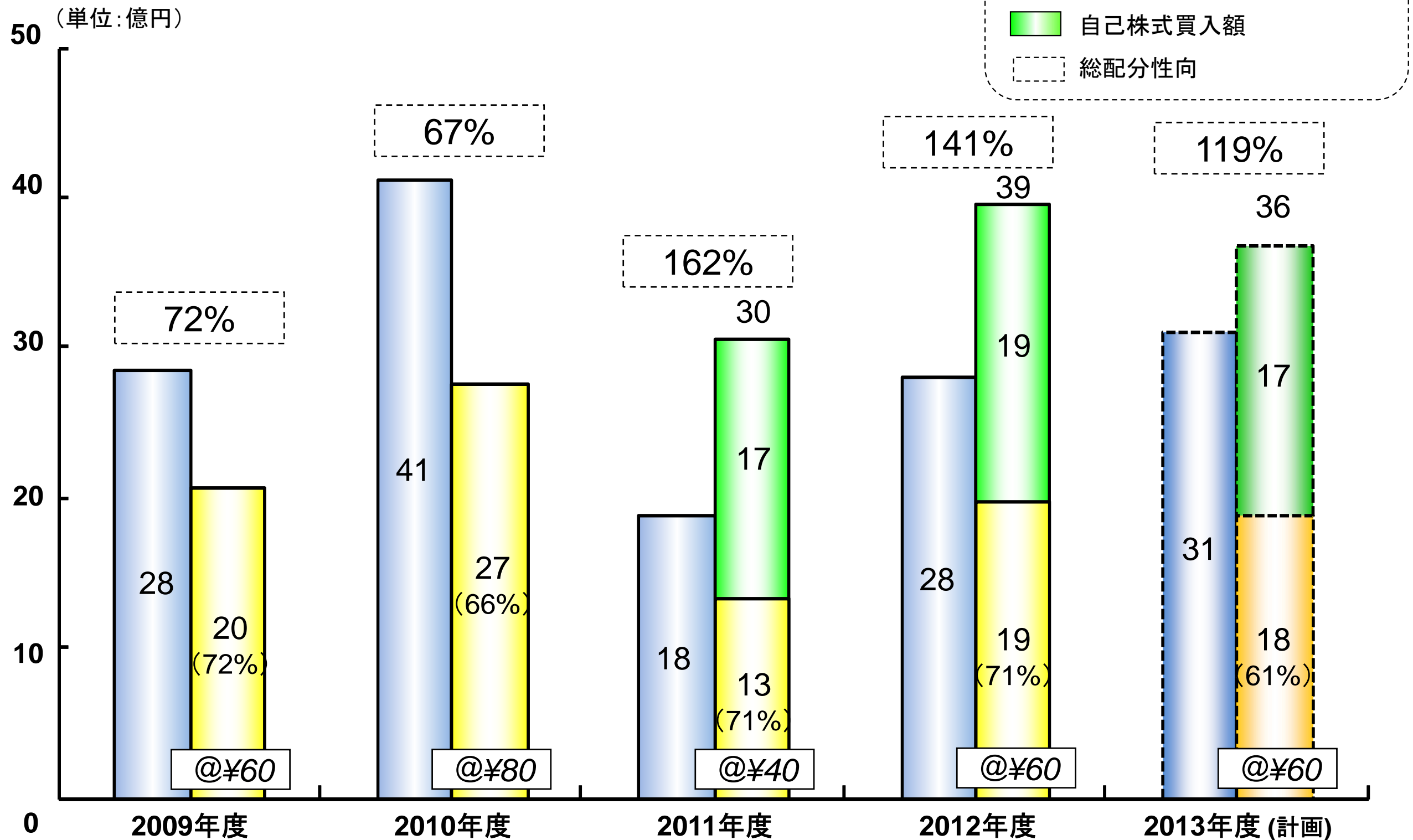
# 連結キャッシュフロー計算書

	2012年度 上期	2013年度 上期	主な要因
	実績	実績	
営業活動によるキャッシュフロー	62	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>・税金等調整前四半期純利益 21</li> <li>・仕入債務の増加 29</li> <li>・売上債権の増加 <math>\Delta 8</math></li> <li>・たな卸資産の増加 <math>\Delta 24</math></li> </ul>
投資活動によるキャッシュフロー	14	$\Delta 2$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有形固定資産の取得 <math>\Delta 1</math></li> <li>・無形固定資産の取得 <math>\Delta 1</math></li> </ul>
フリー・キャッシュフロー	77	11	
財務活動によるキャッシュフロー	$\Delta 12$	$\Delta 27$	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自己株式の取得 <math>\Delta 17</math></li> <li>・配当金の支払い <math>\Delta 9</math></li> <li>・短期借入金の増加 1</li> </ul>
現金及び現金同等物の残高	403	494	

(単位:億円)

# 株主様への利益還元

2011～13年度は各100万株の買入を実施し、消却済み。



2013年度第2四半期 業績結果及び通期予想

2013年度 経営の取り組みの状況

## 【基本的な姿勢】

**「持続的成長」と「健全経営」を目指す**

## 【具体的な取り組み】

### 第2、第3の柱となる事業の育成

- ◇ 海外半導体デバイス事業等の更なる強化
  - ・新規リソース開発プロジェクトの推進
  - ・海外半導体デバイス事業の更なる強化

### 企業体質の更なる改善

- ◇ 収益体質と財務体質の改善
  - ・利益率改善に向けた間断なきチャレンジ
  - ・たな卸資産回転月数の適正化：目標1ヶ月未満



# 「海外半導体デバイス事業等の更なる強化」の状況

## ◆ 「新規リソース開発プロジェクトの推進」の状況

⇒ 新規サプライヤービジネスに取り組むための子会社設立を計画。

## ◆ 「海外半導体デバイス事業の更なる強化」の状況

サクシス **RYOSAN GROUP**  
**SAXIS**

主要サプライヤー: NXP Semiconductors, Macronix International, Entropic Communications,  
Everspin Technologies, ザインエレクトロニクス

⇒ 2013年度は既存サプライヤービジネス拡大に注力。

ジャイロニクス **RYOSAN GROUP**  
**GYRONICS**

主要サプライヤー: Winbond Electronics, Micrel, STMicroelectronics,  
**ATMEL, Faraday Technology, Applied Micro Circuits** (新規取扱サプライヤー)

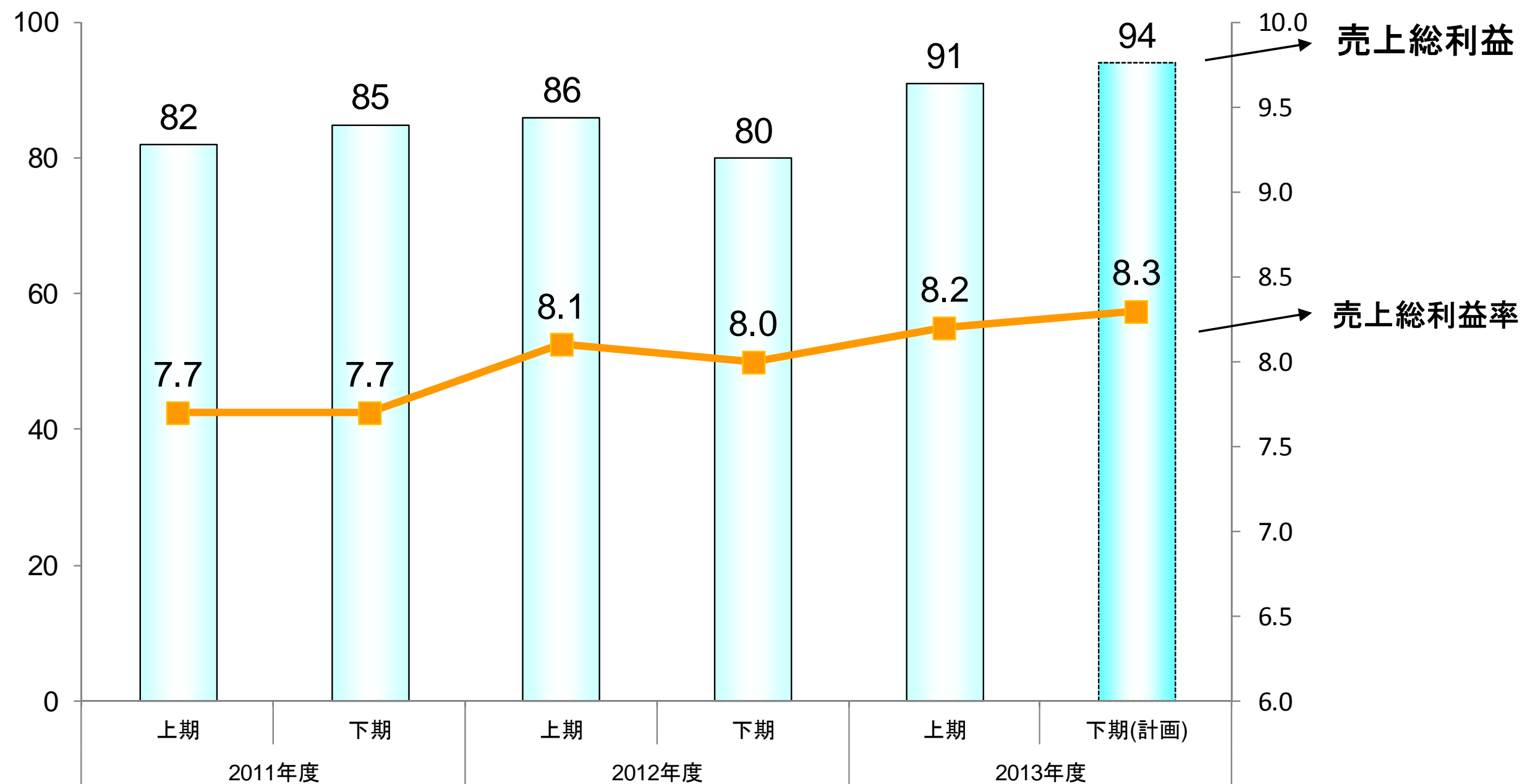
⇒ 2013年度は新規取扱サプライヤービジネスにも注力。

# 「収益体質の改善」の状況

2011年度から収益体質の改善に取り組み、2013年度上期には売上総利益率8.2%まで回復。今後も売上総利益率の改善に努めていく。

## 【売上総利益推移】

(単位:億円)



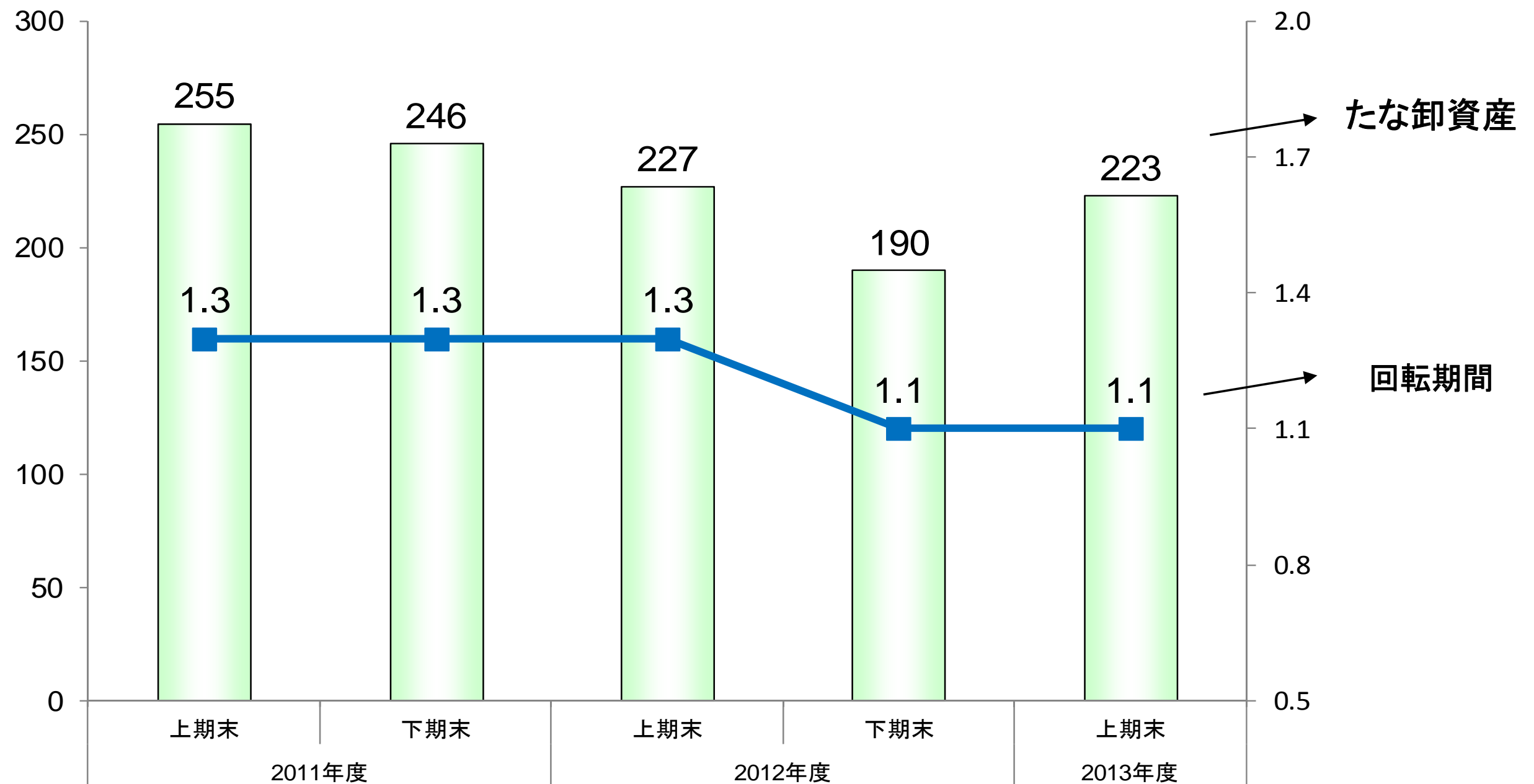
# 「財務体質の改善」の状況

同様に財務体質の改善を推し進め、たな卸資産回転月数は1.1ヶ月まで改善した。  
目標である1ヶ月未満を目指し、適正化を図っていく。

## 【たな卸資産推移】

(単位:億円)

(単位:ヶ月)



# 第8次中期経営計画 成長戦略

## 成長戦略

追加

1. 海外半導体デバイス事業等の  
更なる強化

2. 急成長する新興国市場  
(中国・インド)への取り組み強化

3. グローバル化する日系顧客  
への対応強化

4. 成長分野(カーエレクトロニクス・  
社会インフラ等)の開拓強化

RYOSAN